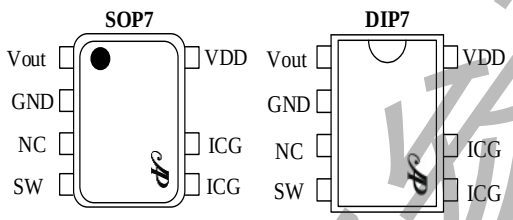
基于高压同步整流架构固定 5V 输出的非隔离交直流转换芯片

概述

AP8505基于高压同步整流架构，集成PFM控制器以及700V高可靠性MOSFET，用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。AP8505内置700V高压启动，实现系统快速启动、超低待机功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能，包括过载保护，欠压保护，过温保护。另外AP8505具有优异的EMI特性。

封装/订购信息



订购代码	封装
AP8505SS-D1	SOP7
AP8505NS-D1	DIP7

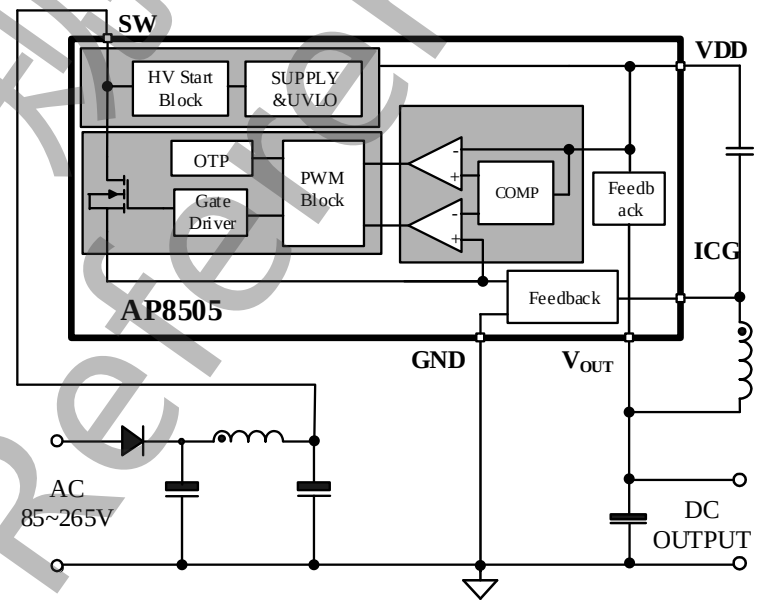
特性

- 内置700V高可靠性MOSFET
- 先进的高压同步整流架构
- 内置高压启动
- 仅适用于Buck、Buck-Boost架构
- 输出电压固定为5V
- 半封闭式稳态输出电流能力200mA @230V_{AC}
- 改善EMI的降频调制技术
- 优异的负载调整率和工作效率
- 全面的保护功能
  - ✧ 过流保护（OCP）
  - ✧ 欠压保护（UVLO）
  - ✧ 过温保护（OTP）

应用领域

- 非隔离辅助电源
- 家电
- 智能家居

典型电路



规格书 Reference Spec